

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

本次修订后的《公司募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

2、同意《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-071。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、同意《关于设立募集资金专项账户的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1202 号），公司本次向特定对象发行股票数量 248,000,000 股，每股发行价格为人民币 20.00 元，募集资金总额为人民币 4,960,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 46,938,949.76 元后，实际募集资金净额为人民币 4,913,061,050.24 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（天健验[2023]603 号）。（详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等文件）

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目之“汽车半导体封装项目（一期）”拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）具体实施、“SiC 功率器件生产线建设项目”拟通过子公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称“士兰明镓”）具体实施。募集资金将以增资的方式投入到成都士兰与士兰明镓。

为规范本次募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意成都士兰在国家开发银行四川省分行开立募集资金专项账户；同意士兰明镓在国家开发银行厦门市分行开立募集资金专项账户。

公司及相关子公司将在上述募集资金账户开立后及时与本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）、开户银行签署募集资金监管协议。

董事会同时授权董事长陈向东先生和公司管理层办理本次募集资金专项账户的开立及四方监管协议签署等具体事宜。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日